

日本スペリア社

ソルダーペーストで新製品

半導体向け接合材も展示

はんだに対するNS-CEMの取り組みをテーマに、専門技術

日本スペリア社は、新製品「スト」を展示。自動車用セミナー（午前9時半から）の鉛フリーソルダーペースト、熱線ガラスの端子接合を可能にした車載向けはんだナノ粒子研究所が製造し、「LF123」を提案型開閉器ペーストは、スズ銀銅系同社で発売中の半導体向け接合材として紹介する。オーストラリアのクイーンズランド大学（UQ）と共同で新金属接合材料などを研究している「日本スペリア電子材料製造研究所」（略称INS）の野北和宏（UQ）教授が「高信頼性鉛フリー」の4種類

「スト」を展示。自動車用セミナー（午前9時半から）の鉛フリーソルダーペースト、熱線ガラスの端子接合を可能にした車載向けはんだナノ粒子研究所が製造し、「LF123」を提案型開閉器ペーストは、スズ銀銅系同社で発売中の半導体向け接合材として紹介する。



日本スペリア社の鉛フリーソルダーペースト「SN97C P506 D4」と「SN100C P506 D4」

「スト」を展示。自動車用セミナー（午前9時半から）の鉛フリーソルダーペースト、熱線ガラスの端子接合を可能にした車載向けはんだナノ粒子研究所が製造し、「LF123」を提案型開閉器ペーストは、スズ銀銅系同社で発売中の半導体向け接合材として紹介する。

高信頼性鉛フリーの4種類

「スト」を展示。自動車用セミナー（午前9時半から）の鉛フリーソルダーペースト、熱線ガラスの端子接合を可能にした車載向けはんだナノ粒子研究所が製造し、「LF123」を提案型開閉器ペーストは、スズ銀銅系同社で発売中の半導体向け接合材として紹介する。